

4-2-3-2 積層板欠陥起因金めっきピット／层压板的缺陷引起镀金层的凹坑 / Pit on gold deposit caused by laminate defect

【特徴】 積層板欠陥そのままの形状をした金めっきピット

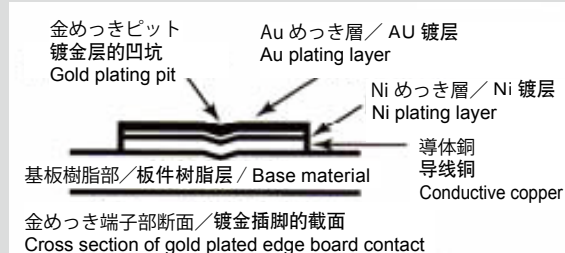
【特徴】 层压板自身有凹陷，使得镀金层出现凹坑。

【Characteristics】 A pit on gold deposit is present exactly reflecting the shape of a laminate defect.

【原因・判断ポイント・発生工程】 積層板欠陥の影響を受けて存在していた銅めっき欠陥の上に金めっきされて出来たもの（銅めっき前～金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】 受到层压板凹陷的影响，镀铜层上出现凹陷，又进行镀金所引起的（镀铜前～镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Gold plating is made on a defect of basis copper originated as a laminate defect. (Before copper plating - gold plating process)



4-2-3-3 下地銅変質起因金めっきピット／基底铜层变质引起的镀金层凹坑 / Pit on gold deposit caused by degraded base copper

【特徴】 小さいピットが一部分に密集している状態の金めっきピット

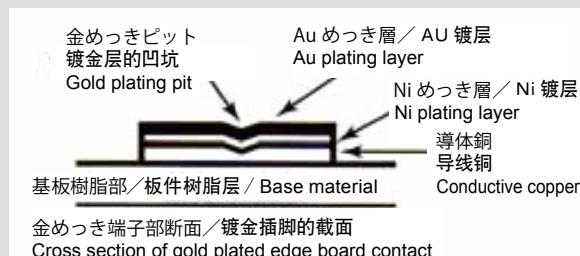
【特徴】 镀金层局部有密集的小凹坑。

【Characteristics】 Small gold plating pits are clustered locally.

【原因・判断ポイント・発生工程】 銅めっき表面の変質に起因して出来たもの（銅めっき～金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】 因为镀铜层表面变质所引起的（镀铜～镀金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 The defect is caused by degradation of the base copper surface (Copper plating - gold plating process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×